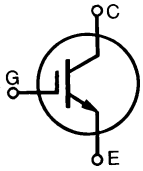
IXYS

HiPerFAST™ IGBT

IXGH 28N90B
IXGT 28N90B

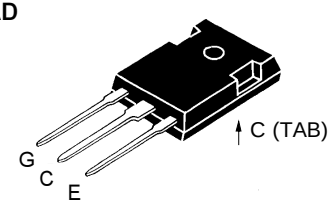
V_{CES}	=	900	V
I_{C25}	=	51	A
$V_{CE(SAT)}$	=	2.7	V
$t_{fi(typ)}$	=	130	ns

Preliminary data sheet

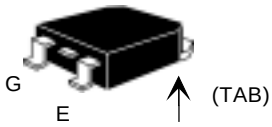


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	T_J = 25°C to 150°C	900	V
V_{CGR}	T_J = 25°C to 150°C; R_{GE} = 1 MΩ	900	V
V_{GES}	Continuous	±20	V
V_{GEM}	Transient	±30	V
I_{C25}	T_C = 25°C	51	A
I_{C110}	T_C = 110°C	28	A
I_{CM}	T_C = 25°C, 1 ms	120	A
SSOA (RBSOA)	V_{GE} = 15 V, T_{VJ} = 125°C, R_G = 10 Ω Clamped inductive load, L = 100 μH	I_{CM} = 56 @ 0.8 V_{CES}	A
P_C	T_C = 25°C	200	W
T_J		-55 ... +150	°C
T_{JM}		150	°C
T_{stg}		-55 ... +150	°C
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	°C
M_d	Mounting torque (M3)	1.13/10Nm/lb.in.	
Weight	TO-247 AD TO-247 SMD	6 4	g g

TO-247 AD (IXGH)



TO-268 (D3) (IXGT)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values (T_J = 25°C, unless otherwise specified) min.	typ.	max.	
BV_{CES}	I_C = 250 μA, V_{GE} = 0 V		900			V
$V_{GE(th)}$	I_C = 250 μA, V_{CE} = V_{GE}		2.5		5	V
I_{CES}	V_{CE} = V_{CES} V_{GE} = 0 V	T_J = 25°C T_J = 150°C			500 5	μA mA
I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = ±20 V				±100	nA
$V_{CE(sat)}$	I_C = I_{C110}, V_{GE} = 15 V			2.2	2.7	V

Features
- International standard packages JEDEC TO-268 surface mountable and JEDEC TO-247 AD
- High current handling capability
- Latest generation HDMOS™ process
- MOS Gate turn-on
  - drive simplicity

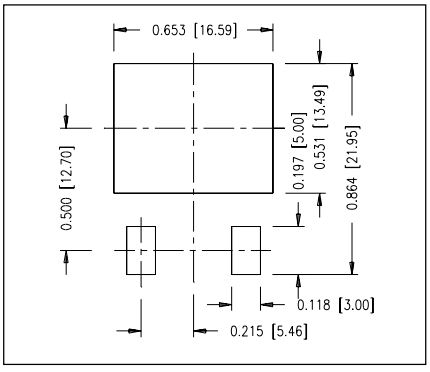
Applications
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

Advantages
- Space savings (two devices in one package)
- High power density
- Suitable for surface mounting
- Switching speed for high frequency applications
- Easy to mount with 1 screw, TO-247 (isolated mounting screw hole)

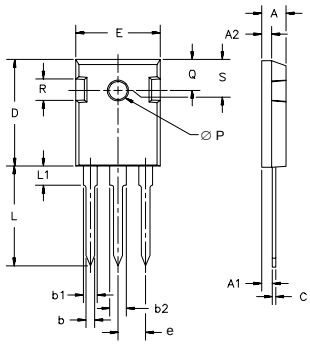
© 2000 IXYS All rights reserved

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T_J = 25°C, unless otherwise specified) min.	typ.	max.	
g_{fs}	$I_C = I_{C110}$; V_{CE} = 10 V, Pulse test, t ≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 %	20	32		S
C_{ies}	V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V, f = 1 MHz		3200		pF
C_{oes}			160		pF
C_{res}			32		pF
Q_g	$I_C = I_{C110}$, V_{GE} = 15 V, V_{CE} = 0.5 V_{CES}		100	150	nC
Q_{ge}			18	28	nC
Q_{gc}			40	70	nC
$t_{d(on)}$	**Inductive load, T_J = 25°C**		30		ns
t_{ri}	$I_C = I_{C110}$, V_{GE} = 15 V		30		ns
$t_{d(off)}$	V_{CE} = 0.8 V_{CES}, $R_G = R_{off}$ = 4.7 Ω		100	170	ns
t_{fi}	Remarks: Switching times may		130	220	ns
E_{off}	increase for V_{CE} (Clamp) > 0.8 • V_{CES}, higher T_J or increased R_G		1.2	2	mJ
$t_{d(on)}$	**Inductive load, T_J = 125°C**		30		ns
t_{ri}	$I_C = I_{C110}$, V_{GE} = 15 V		35		ns
E_{on}	V_{CE} = 0.8 V_{CES}, $R_G = R_{off}$ = 4.7 Ω		0.3		mJ
$t_{d(off)}$	Remarks: Switching times may		280		ns
t_{fi}	increase for V_{CE} (Clamp) > 0.8 • V_{CES},		190		ns
E_{off}	higher T_J or increased R_G		2.5		mJ
R_{thJC}				0.62	K/W
R_{thCK}	TO-247		0.25		K/W

Min Recommended Footprint

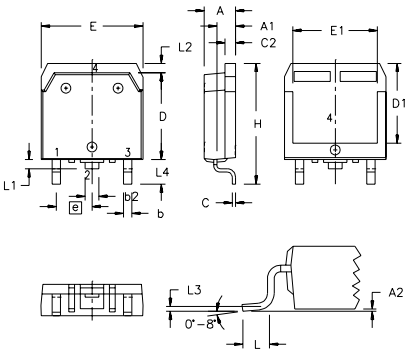


TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter Min.	Max.	Inches Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A_1	2.2	2.54	.087	.102
A_2	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b_1	1.65	2.13	.065	.084
b_2	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15 BSC		242 BSC	

TO-268 Outline



SYM	INCHES MIN	MAX	MILLIMETERS MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.